



技术要求

1. 未注尺寸公差±0.1。
2. 未注倒角C0.5。

			热处理			表面处理		
						代号 SY-COM-6DIO-0.5A		
变更版本		变更人签字	日期		材料			
设计					重量	数量	比例	名称 串口IO模块
制图							1:1	
校对					阶段标记			
审核					共张	第张		
深圳市双翌光电科技有限公司								